

储存芯片展-2024年芯片封装测试展智能制造展

产品名称	储存芯片展-2024年芯片封装测试展智能制造展
公司名称	中国（耀瀚）展会信息
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国
联系电话	17810353883 17810353883

产品详情

SEMI-e2024第六届深圳国际半导体技术暨应用展览会

展览时间：2024年06月26-28日 展览地点：深圳市国际会展中心（宝安新馆）

展出面积场 60,000 平方米，参展企业800+家，参观观众60,000 人，主题活动 40+场。

2024年第六届深圳半导体展会将于2024年6月26日至28日在深圳国际会展中心举行。作为中国最大的半导体展会之一，本届展会将继续展示最新的半导体技术和产品，促进业界的交流与合作。

本届展会将汇集quanqiulingxian的半导体企业，展示最新的芯片设计、制造工艺、封装测试等技术，以及在智能家居、智能制造、物联网、人工智能等领域的应用。展会将展示国内外先进的半导体设备、材料、零部件等，为产业链上下游企业提供一站式的采购平台。

在参展商方面，本届展会将汇集国内外zhiming的半导体企业，包括台积电、联发科、华为、中兴通讯、联想等。这些企业将展示最新的技术和产品，并与来自世界各地的客户和合作伙伴进行深入交流。

除了展示最新的技术和产品外，本届展会还将举办一系列互动活动，包括技术讲座、新品发布、设计师沙龙等，吸引更多的观众参与其中。此外，展会还将设立专门的洽谈区和休息区，方便参展商和观众进行深入交流和休息。

展示范围1、设计、芯片、晶圆制造与封装：集成电路设计及芯片、晶圆制造、SiP先进封装、功率器件封测、MEMS封测、硅晶圆及IC封装载板、封装基板与应用制造与封测、EDA、MCU、封装基板半导体材料与设备及零部件等

2、先进材料：硅片及硅基材料、光掩模板、电子气体、光刻胶及其配套试剂、CMP抛光材料、靶材、封装基板、引线框架、键合丝、陶瓷基板、芯片粘合材料等

- 3、IC载板/陶瓷基板：IC载板及封装工艺(基板、铜等结构材料及干膜、金盐等化学品/耗材) Chiplet封装技术、存储、MEMS及芯片应用及材料、设备。陶瓷基板与封装材料及设备等
- 4、半导体显示/Mini/Micro-LED：OLED、AMOLED、Mini/Micro LED显示、柔性显示与材料及设备等
- 5、半导体专用设备&零部件：减薄机、单品炉、研磨机、热处理设备、光刻机、刻蚀机、离子注入设备、CVD/PVD设备、清洗设备切割机、装片机、键合机、测试机、分选机、探针台及零部件等
- 6、第三代半导体：氮化(GaN)和碳化硅(SiC)、氧化锌(ZnO)、金刚石、晶圆、衬底与外延、功率器件、IGBT封装材料、射频器件及加工设备等
- 7、元器件：无源器件、半导体分立器件/IGBT、5G核心元器件特种电子、元器件。电源管理、传感器、存储器、连接器继电器、线缆、接插器件、晶振、电阻、显示器件、二极管、三极管滤波元件、开关及元器件材料及设备等
- 8、机器视觉与传感器：各类感知元件、执行器、智能传感器、工业传感器、传感器芯片、传感器生产与制造设备、配件等
- 9、电源&储能技术：储能电源及传感器、电池管理芯片、功率半导体器件及材料和相关设备、仪器及零部件等
- 10、毫米波雷达/激光雷达/自动驾驶：毫米波雷达模组、射频芯片、天线及高频PCB、高频材料、生产组装设备等汽车雷达传感器上下游供应链各环节产品等
- 11、微电子综合智造区：电子自动化、机器自动化、视觉检测、环保、清洗设备、检测设备、测试仪器、配件等
- 12、AI与算力、算法、存储、CPO共封装：人工智能芯片、方案、算力芯片及方案、算法方案数据存储、光电共封装模块及技术和设备等
- 13、汽车半导体/车规级先进封装技术：车规级半导体主控/计算类芯片、功率半导体(IGBT和MOSFET)、车规级SiC模块、电源管理芯片、汽车电子微组装及功率器件、封装测试设备、自动化设备、国际半导体材料商、zhiming设备商、zhiming封测、制造、代工厂商等

2024第六届SEMI-e 深圳国际半导体技术暨应用展览会定档于2024年6月26日-6月28日在深圳国际会展中心（宝安新馆）举行！为产业链的升阶发展搭建供需精准对接、双向奔赴的平台，探索半导体行业发展新路径，共掘半导体行业新风口！

为全球半导体产业的发展注入新的动力，促进业界的交流与合作。我们期待着与您共同见证这一盛会，探索半导体技术的未来发展前景。